

Q1：什么是 wafer cassette ？

A1：wafer cassette 通常称之为：晶圆承载盒，主要是应用于半导体芯片工厂用来承载晶圆，制程使用，传送晶圆之容器。我司是日本大日商社的 wafer cassette 在中国区代理商，产品分别有：不同材质 wafer cassette.

Q2：wafer cassette 是怎么制造出来的？

A2：对于塑胶材质的 wafer cassette 通常都是经过原材料成分配比后，热熔后再注塑，通过模具一体成型。制造工艺中，模具尺寸的精准度，注塑后温度以及缩水率的控制，将直接影响 wafer cassette 产品的质量。

Q3：CO2 灭火系统有哪些火灾探测方式？

A3：主要通过温度感应器，火焰（光敏）感应器和烟雾感应器。其中温度感应器包括针型和线型，火焰感应器包括红外感应和紫外感应。

Q4：如何判断合适的钢瓶？

A4：符合 FM 规范灭火系统，防护区 EXHAUST DAMPER 在 CO2 灭火系统作动时不需要关闭。设计时需要考虑 EXHAUST 损耗。钢瓶大小根据以下计算公式的结果得出。

计算公式： $Q = [(V * A * 1.6) + (L * A * 1.6)]$ 其中：Q：CO2 总用量(kg)；V：防护空间体积(m3)；A：设备总体积参数；L：设备 EXHAUST 抽风量(m3/min)

Q5:请问什么叫 CMP?

A5 :CMP为Chemical Mechanical Polishing的缩写，称之为化学机械研磨，是半导体芯片制造工艺中的一种技术，用来对正在加工中的芯片或其它衬底材料进行平坦化处理

Q6: 化学机械研磨工作原理是什么？

A6: 概括来说，化学机械研磨是把硅片放在旋转的研磨垫(Pad)上，再加一定的压力，用化学研磨液(Slurry)来研磨的